



明新科技大學112學年度教師產業研習 半導體封裝技術與核心實務培訓營招生簡章

主辦單位 明新科技大學

第一梯次(10天，共70小時)

日期	時間	培訓內容	講員	服務機構及職稱
1/22 (一)	08:30-12:00	半導體構裝技術的演變	羅勉成	世芯電子公司專案顧問
	13:00-16:30	認識晶圓切割機組成與功能	何信松	力成科技公司資深工程師
1/23 (二)	08:30-12:00	IC 產業發展願景	呂明峯	明新科技大學電子工程系教授
	13:00-16:30	晶圓切割機人機介面參數設定	何信松	力成科技公司資深工程師
1/24 (三)	08:30-12:00	半導體製程技術	陳炳茂	明新科技大學半導體與光電科技系副教授
	13:00-16:30	晶圓切割機檢測與基本故障排除	何信松	力成科技公司資深工程師
1/25 (四)	08:30-12:00	半導體製程技術	陳炳茂	明新科技大學半導體與光電科技系副教授
	13:00-16:30	晶圓切割機實務程序操作	何信松	力成科技公司資深工程師
1/26 (五)	08:30-12:00	半導體製程技術	陳炳茂	明新科技大學半導體與光電科技系副教授
	13:00-16:30	認識固晶機組成與功能	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/29 (一)	08:30-12:00	半導體封裝綜覽	蔡天寶	力成股份有限公司封裝製造暨設備整合處處長
	13:00-16:30	固晶機人機介面參數設定	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/30 (二)	08:30-12:00	基礎半導體封裝概論	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長
	13:00-16:30	固晶機檢測與基本故障排除	林賢昇	力成科技公司資深工程師
1/31 (三)	08:30-12:00	半導體封裝第一階層連接方式	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長
	13:00-16:30	固晶機實務程序操作	林賢昇	力成科技公司資深工程師
2/1 (四)	08:30-12:00	典型封裝製程技術	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長
	13:00-16:30	認識 QFN 封裝設備組成與功能	鄭國偉	廣化科技股份有限公司業務處經理
2/2 (五)	08:30-12:00	3D 封裝製程	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長
	13:00-16:30	QFN 封裝設備人機介面參數設定	陳慶恩	廣化科技股份有限公司關鍵技術研發處資深研發工程師

課程時間/
課程名稱/
師資

第二梯次(10天，共70小時)

日期	時間	培訓內容	講員	服務機構
7/1 (一)	08:30-12:00	半導體產業的發展與挑戰	呂明峯	明新科技大學電子工程系教授
	13:00-16:30	QFN 封裝設備檢測與基本故障排除	陳慶源	廣化科技股份有限公司 生產處資深工程師
7/2 (二)	08:30-12:00	先進封裝工程概論	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長
	13:00-16:30	QFN 封裝設備實務程序操作	陳慶源	廣化科技股份有限公司生產處資深工程師
7/3 (三)	08:30-12:00	晶圓級封裝製程	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長
	13:00-16:30	認識打線機組成與功能	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/4 (四)	08:30-12:00	面板級封裝製程	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長
	13:00-16:30	打線機人機介面參數設定	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/5 (五)	08:30-12:00	先進封裝的發展趨勢	王欽宏	工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組組長
	13:00-16:30	打線機檢測與基本故障排除	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/8 (一)	08:30-12:00	先進封裝的技術挑戰	張香鈺	工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組經理
	13:00-16:30	打線機實務程序操作	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/9 (二)	08:30-12:00	先進封裝製程實務	張香鈺	工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組經理
	13:00-16:30	晶圓切割機操作能力檢測	何信松	力成科技公司資深工程師
7/10 (三)	08:30-12:00	IC 封裝產業環境汙染處理	江鍇帆	力成股份有限公司工安二部副部經理
	13:00-16:30	固晶機操作能力檢測	林賢昇	力成科技公司資深工程師
7/11 (四)	08:30-12:00	封裝產業廠務系統介紹	盧麒泰	力成股份有限公司廠務副部經理
	13:00-16:30	打線機操作能力檢測	黃志賢	力成科技公司資深工程師
7/12 (五)	08:30-12:00	半導體封裝製程學習評量	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體封測類產線營運長
	13:00-16:30	半導體封裝設備核心實務評量	蔡天寶	力成股份有限公司封裝製造暨設備整合處處長



開課日期	第一梯次 113年1月22日(一)至113年2月2日(五) 每周一至周五 早上8:30至16:30 第二梯次 113年7月1日(一)至113年7月12日(五) 每周一至周五 早上8:30至16:30
開課地點	明新科技大學逢喜樓(209教室) 半導體封裝測試類產線基地
合作機構	明志科技大學教師產業研習研究專案辦公室 工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組 力成科技股份有限公司 廣化科技股份有限公司
參與對象	高中職及大專院校教師
收費標準	免費
招生人數	招生人數40人(校外16人、校內24人)
報名網址	https://forms.gle/Wjm3viG6Tv8pvD146
結訓要求	每梯次缺席率達25%以上(含)，不頒發當前梯次結業證書。